

SEDEX 2023 Review

2023. 11.

반도체대전, 5만여명 방문으로 성황리에 폐막

- ✓ 국내 반도체산업계 최대 행사인 반도체대전 'SEDEX 2023'이 사흘 간의 일정을 마치고 폐막했다. 반도체 장비, 소재, 부품, 설계, 재료, 설비기업 등 반도체 산업 생태계를 구성하는 쏠 분야 320개 기업이 830부스의 규모로 치러진 올해 반도체대전은 역대 최대 규모로 개최되어 많은 성장이 있었다.
- ✓ 반도체 화두 AI반도체 어디까지 왔나=전시회 슬로건을 'AI와 반도체 혁신, 미래를 연결하는 힘'으로 정하고 관련 분야에 심층적으로 접근할 수 있는 무대 또한 마련되었다.
- ✓ 삼성전자는 차세대 메모리 반도체 모듈인 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 최선단 파운드리 공정, 첨단 패키징기술, 올해 개발완료 소식을 알린 엑시노스 2400칩을 포함 AI반도체에 걸맞은 다양한 칩들이 소개되었다. 또한 AI, 오토모티브, 모바일 등 응용처별 다양한 차세대 반도체 제품을 선보였다.
- ✓ SK하이닉스는 올해 가장 뜨거웠던 반도체인 고대역폭메모리(HBM)의 최신제품 HBM3E를 소개했다. 메모리 안에서 도 연산을 할 수 있는 프로세싱 인 메모리(PIM) 기반 AI 가속기 카드 'AiMX'를 비롯해 서버용 DDR5D램, 임베디드 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 저장 장치 등이 전시되었다.

1. SEDEX Overview

▶ 행사 : 제25회 반도체대전 (SEDEX, Semiconductor Exhibition)

▶ 장소 : COEX Hall C&D1 (3F)

* 한국전자展 : Hall A&B (1F)

▶ 기간 : 2023년 10월 25일(수)~27일(금)

▶ 규모 : 320개사 830부스

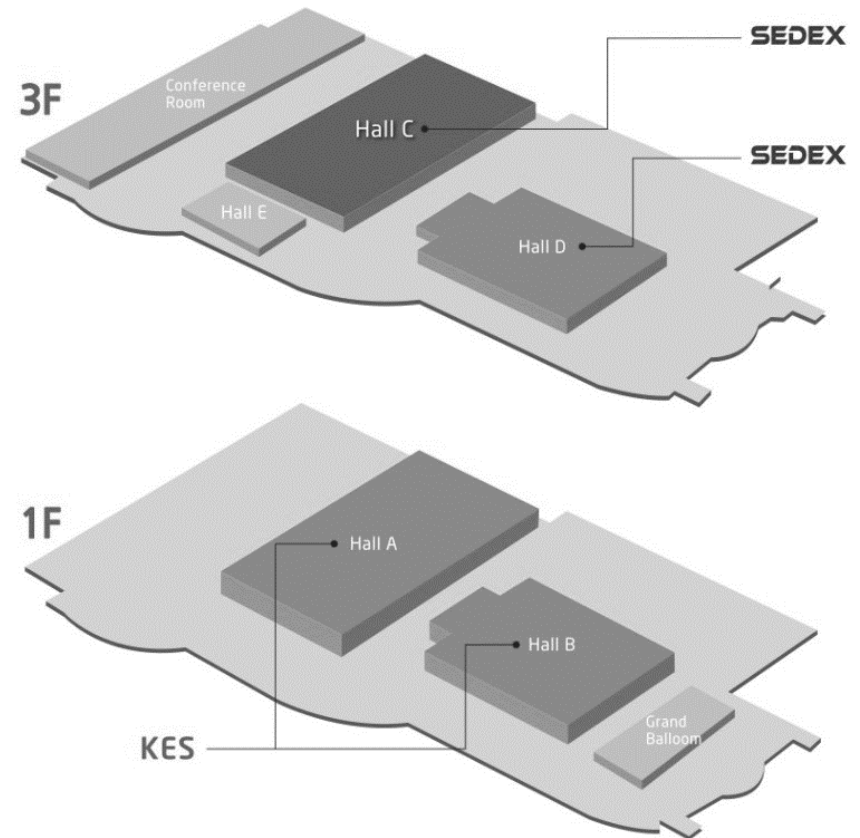
* 한국전자산업대전 450개사 1,200개부스 32,362㎡

▶ 관람 : 52,162명

* 한국전자산업대전(A~D홀) 60,549명 (10% 증가)

▶ 주관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

▶ 후원 : SK하이닉스, 삼성전자, 시놉시스,
어플라이드머티리얼즈



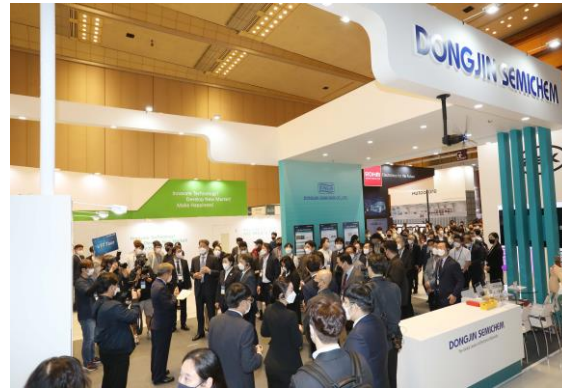
- 스마트폰, TV 등 반도체 수요제품부터 메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체산업 **생태계 주 분야가 참여**
- 전시회 참가기업 상호간 공급/수요기업이 되는 **산업 생태계형 전시회** 로 전시기간 동안 홍보·비즈니스의 장으로 활용 가능
- 네덜란드, 벨기에, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공
- **동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)과 더불어 개최** 되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술정보 확보 및 홍보효과 기대

2. SEDEX Review

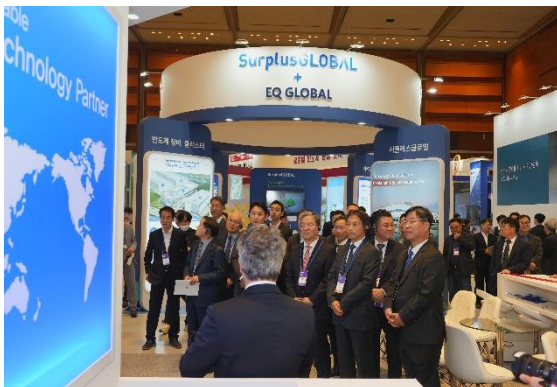


SEDEX Keynote

- ✓ 반도체대전 개막 이튿날인 10/26(목)에는 삼성전자 박용인 사장, 한국과학기술원 김정호 교수, 리벨리온 박성현 대표가 ‘AI와 반도체 혁신, 미래를 연결하는 힘’, Linking a Path to the Future : AI and Semiconductor Innovation’을 주제로 키노트 스피치가 진행되었다.
- ✓ 삼성전자 박용인 사장은 “기존 클라우드 중심의 AI 시대에서 영역을 엣지단으로 확대해 ‘온디바이스 AI’가 기술적 혁신으로 이어질 것”이라고 했다. 또한 ‘클라우드 유지비용’, ‘사용자와 클라우드 간의 네트워크 지연’, ‘개인정보보호’를 3가지의 해결해야 할 문제점으로 꼽았다.
- ✓ AI 전문가로 통하는 김정호 한국과학기술원 교수는 “생성형 AI는 인간 두뇌활동의 효율성을 100배, 1000배 높일 것”이라며 “기업과 개인은 앞으로 생성형 AI를 확보했느냐 아니냐 여부에 따라서 미래가 갈릴 것”이라고 AI의 중요성을 강조했다.
- ✓ 국내 대표 팹리스인 리벨리온의 박성현 대표는 “엔디비아처럼 GPU 등 인프라를 잡지 못하면 기업들이 AI 경쟁력을 확보할 수 없다”라며 “한국은 하드웨어를 잘 만드는 만큼 AI 반도체에서도 잘할 것”이라고 말했다.



✓ 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보인다. ▲ **삼성전자**는 가장 큰 규모로 참가했으며 CMM(CXL 메모리 모듈)과 같은 고성능 컴퓨팅 플랫폼용 신규 인터페이스 제품군부터 최첨단 파운드리 공정, 어드밴스드 패키지 기술을 선보였다. ▲ **SK하이닉스**는 글로벌 톱 수준의 AI 메모리 제품과 기술을 선보였다. 초고성능 메모리 반도체인 HBM 신제품인 'HBM3E', PIM 기반 AI 가속기 카드 'AiMX'를 비롯해 최신 규격의 서버용 DDR5, eSSD 등을 전시했다. ▲ **LX세미콘**은 차량 및 가전용 시스템 반도체 등을 선보이며 미래 성장동력을 제시했다. ▲ 반도체 클린룸 분야를 선도해온 기업인 **신성이엔지**는 클린룸과 더불어 이차전지 드라이룸 제조 장비와 기술을 소개하였다. ▲ **램리서치**는 Coronus® 플라스마 베벨 클린 모듈의 미니어처 모형을 선보였다.

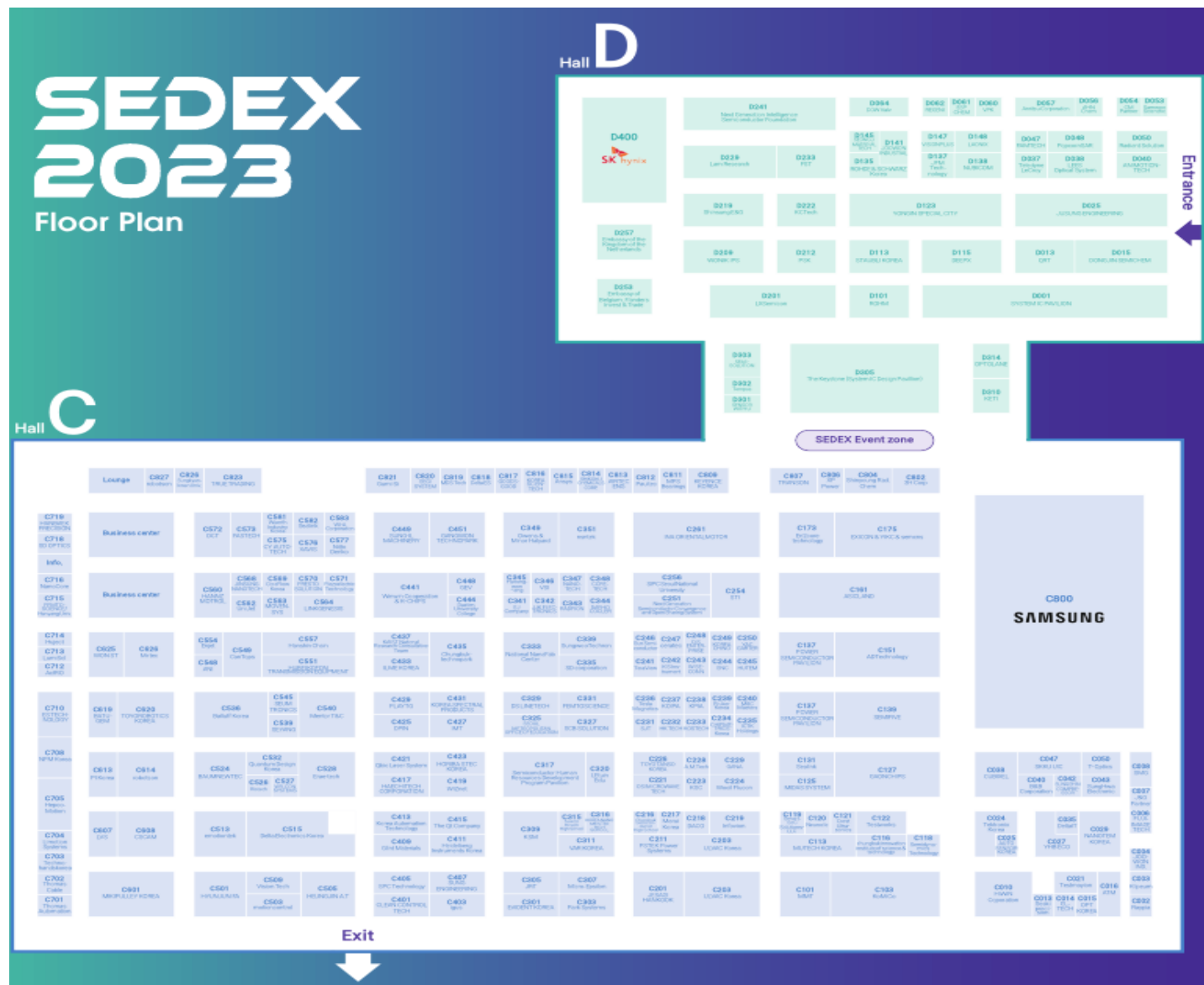




- ✓ 시스템반도체 분야에서 두각을 드러내는 딥엑스와 오픈엠티테크놀로지 등도 참여했다. ▲ AI 반도체 칩을 설계하는 **딥엑스**는 서버급 제품인 'DX-H1'의 실시간 데모를 최초로 선보였다. ▲ AI통합 IP 플랫폼 기업인 **오픈엠티테크놀로지**는 인라이트가 탑재된 사물경계인식모델 (YOLACT) 신경망 데모 체험 공간을 마련했다. ▲ **에이디테크놀로지**는 회로 변경이 불가능한 일반 반도체와 달리 고객사의 요구에 맞게 회로를 다시 새겨넣을 수 있는 반도체인 프로그래머블 반도체(FPGA) 플랫폼을 선보였다. ▲ **에이직랜드**는 자사의 설계 자동화 솔루션 'ALPS'와 'Aworld Magic'을 공개하였다. ▲ **세미파이브**는 자사가 보유한 핵심 역량을 엔지니어링, 원천기술(IP), 설계자동화, 소프트웨어, 후공정 기술의 5가지 주제로 선보였다.



- ✓ 이외에도 최고의 반도체 기술력을 가지고 있는 기업들이 참여했다. ▲ 첨단 감광액 스마트 공장을 구축한 **동진씨미켄**은 포토레지스트를 비롯해 반사 방지막(BARC), SOC(Spin-On-Carbon), 연마제(CMP Slurry) 등 반도체용 전자 재료 주요 소재를 전시했다. ▲ **PSK**는 반도체 제조 과정에서 남은 감광액을 제거하는 장비인 PR 드라이 스트립(Dry Strip) 장비를 선보였다. ▲ **엑시콘**은 메모리와 대용량저장장치(SSD)에 이어 상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 이미지 센서 검사 장비를 가져왔다. ▲ **인아그룹**은 스펙을 재정의한다는 의미의 'RE:SPEC'을 콘셉트로 반도체 업계에서 필요로 하는 스펙을 갖춘 다양한 제품 연계를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 선보였다. ▲ 국내 대표 장비기업인 **주성엔지니어링**과 **원익IPS**도 참가하여 자사의 기술력을 선보였다.
- ✓ 이번 전시에서는 지방자치단체의 관심 또한 높았다. ▲ **용인특례시**는 반도체 산업 정책 전반을 알리는 홍보관을 운영하며 반도체 제조 공정을 아우르는 밸류 체인(Value chain) 구축과 시가 중점 추진하고 있는 '용인 L자형 반도체 벨트'를 소개하고 기업 유치를 위한 상담을 제공했다. ▲ **강원특별자치도**는 강원테크노파크, 원주시와 함께 공동홍보관 운영을 통해 강원특별자치도의 반도체 산업 및 투자 환경소개, 지원 분야, 반도체 교육센터 홍보 등을 진행했다. ▲ **충청북도**는 반도체 산업 주요 현황, 혁신기관 및 기업 생태계, 최근 발표한 충북 반도체 전략 2.0등을 홍보하는 등 충북 반도체 현재와 미래를 제시하고 중부권 핵심 거점으로서의 잠재성을 홍보했다.
- ✓ 인력에 대한 관심이 높은 만큼 SEDEX 2023에서는 반도체 인력양성사업 홍보관을 운영하였다. 시스템반도체 설계, 소재·부품·장비기술, 불량분석·품질관리 등 반도체 전문인력양성사업의 안내와 참여대학과 기업은 물론 졸업 후 직무까지 다양한 정보를 담았다. ▲ **램리서치**는 현직 엔지니어와 인사팀이 이공계 대학생을 대상으로 직무 소개와 커리어 멘토링을 제공하는 'Lam&Talk' 세션을 마련했다. ▲ **에이디테크놀로지**와 **가온칩스** 등도 신입사원 채용 안내판을 선보임과 동시에 현장 기업설명회를 진행했다.
- ✓ 국가관들의 관심도 여전했다. ▲ **네덜란드**와 **벨기에**에서 관련 기업들이 대거 국가관으로 참여하였다. 네덜란드에서는 ASM, Boschman, Prodrive 등과 벨기에의 Icsense, Leuven Air Bearings 등이 참여하여 한국 기업과 더욱 더 활발한 교류를 기대하였다.



4. Exhibitor List : 320개사

업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스	업체명	부스
레이피아	C002	서울특별시교육청 취업지원센터	C325	한백정밀	C719	셀링크	C131	충북도청/충북테크노파크	C435	큐알티	D013	아이씨케이 홀딩스	C235	씨와이오토텍	C575	에프에스티	D233
클리퍼움	C003	SCB솔루션	C327	삼성전자	C800	파워큐브세미	C137	한국과학기술원	C437	동진씨미컴	D015	테슬라마크네틱스	C236	자비스	C576	주한 벨기에대사관	D253
주원	C004	동서라인텍	C329	쓰리에치코퍼레이션	C802	시지트로닉스	C137	대림대학교 신산업 특화사업단	C444	주성엔지니어링	D025	한국지식재산보호원	C237	한국닛도테크	C577	주한 네덜란드 대사관	D257
후지이미지테크	C006	펄로사이언스	C331	신영라드컴	C804	아이언디바이스	C137	제브	C448	텔레다인크로이	D037	한국실장산업협회	C238	뷰르트인더스트리코리아	C581	센서위드유	D301
제이엔지파트너	C007	나노종합기술원	C333	엑스피 파워	C806	에스피반도체	C137	성일기공	C449	리스광시스템	D038	브루커코리아	C239	셀링크	C582	템퍼스	D302
에스엠지	C008	에스디상사	C335	트랜스온	C807	세미파워텍스	C137	강원특별자치도	C451	애니모션텍	D040	엠씨마스터스	C240	위아코퍼레이션	C583	세미솔루션	D303
하이원코퍼레이션	C010	성우테크론	C339	키엔스코리아	C809	트리노테크놀로지	C137	현준에프에이	C501	팜테크	D047	테라뷰	C241	미카폴리코리아	C601	칩스앤미디어	D305
세기정밀	C013	에스제이컴퍼니	C341	엠피에스베어링	C811	부산테크노파크	C137	모션컨트롤	C503	팝콘사	D048	키스인스트루먼트	C242	엘브이에스	C607	비트리	D305
지엘테크	C014	제이제이케이전자	C342	폴텍	C812	지엠체코	C137	홍진에이티	C505	래디언트솔루션	D050	와이즈컨	C243	씨엑스캠	C608	블루닷	D305
오피티코리아	C015	라드파온	C343	에어텍이엔지	C813	퀀타마티리얼스	C137	비전텍	C509	삼우과학	D053	에스앤씨	C244	피아이코리아	C613	아크칩스	D305
에이티엠이엔씨	C016	대호냉각기	C344	SHIKOKU CHEMICALS CORP.	C814	악셀	C137	이모션텍	C513	씨엠파트너	D054	쥬템	C245	로보티즈	C614	알파솔루션즈	D305
테스트메이션	C021	형원이엔지	C345	엔시스	C815	루미지엔텍	C137	델타일렉트로닉스코리아	C515	안컴	D056	선한도체	C246	바투캠	C619	오픈넷지테크놀로지	D305
텍트로닉스	C024	브이에스아이	C346	코리아사이언텍	C816	세미파인브	C139	바움뉴텍	C524	안리스크로퍼레이션	D057	세라텍	C247	토요로보틱스 코리아	C620	랩쉽	D305
오트센스코리아	C025	나노테크	C347	굿스굿	C817	에이디테크놀로지	C151	리오맥	C526	브이피케이	D060	디에스엔터프라이즈	C248	원에스티	C625	필리타스반도체	D305
와이에치비에코	C027	코아텍	C348	델타이에스	C818	에이직랜드	C161	웰콘시스템즈	C527	이엑스피컴	D061	한국지노	C249	미르기술	C626	에디엔씨	D305
나노멤코리아	C029	Owens & Minor Halyard	C349	MDS테크	C819	인투코어테크놀로지	C173	이러텍	C528	리전아이	D062	와이에이씨가터 한국지점	C250	토마스오토메이션	C701	아르고	D305
델타아이티	C035	엔에스엔텍	C351	세기시스템	C820	엑시콘	C175	퀀텀디자인 코리아	C532	다우벨브	D064	혁신융합대학 차세대 반도체사업단	C251	토마스케이블	C702	레오에스앤에스	D305
큐박셀	C038	크린컨테크	C401	구미시	C821	와이어이케이	C175	발루프코리아	C536	로움세미컨덕터코리아	D101	에스티아이	C254	테크노핵스코리아	C703	유니컨	D305
비엔비 상사	C040	한국이구스	C403	두루무역	C823	샘시엔에스	C175	세양교역	C539	스토브리코리아	D113	서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터	C256	라이모션	C704	네메시스	D305
성신컴프레사	C042	에스피씨테크놀로지	C405	성균관대학교ERC	C826	제4기한국	C201	멘티엔씨	C540	답역스	D115	인아오리엔탈모터	C261	해코모션	C705	셀리코	D305
성화전자	C043	성엔지니어링	C407	로보슨	C827	한국일박	C203	세움트로닉스	C545	용인특례시	D123	에버던트 코리아	C301	엔피엠코리아	C708	솔리드뷰	D305
성균관대학교 산학협력단	C047	글린트마티리얼즈	C409	윙프솔루션	D001	피에스텍	C211	에이엔아이	C548	서플러스글로벌	D123	파크시스템스	C303	이엑스테크놀로지	C710	파인스	D305
티움텍스	C050	하이델베르크 인스트루먼트 코리아	C411	미연구소	D001	충북반도체고등학교	C216	캔덱스	C549	이규글로벌	D123	한국제이알티	C305	엑트로	C712	SB솔루션	D305
엘엠티	C101	한국자동차기술	C413	쓰리에이로직스	D001	한국마루이	C217	후베이 코먼	C551	로데슈바르츠코리아	D135	마이크로엠피실론코리아	C307	루미솔	C713	에스포시이노	D305
코미코	C103	더큐티컴파니	C415	디엔	D001	대륙	C218	엔텍	C554	제이에프엠테크	D137	KSM	C309	쥬적트	C714	에이아이텍	D305
뮤텍코리아	C113	해지텍	C417	파워엘에스아이	D001	인포비온	C219	한신체인	C557	누베콤	D138	바리코리아	C311	펄로사이언스(부산대학교)	C715	KETI	D310
충북과학기술혁신원	C116	위즈네트	C419	소테리아	D001	오에스아이	C221	한츠모토	C560	주원	D141	수원하이테크고등학교	C315	한양대학교	C715	옵트레인	D314
Semidynamics Technology	C118	큐빅레이저시스템	C421	하이퍼엑셀	D001	케이에스씨	C223	유니넷	C562	성지소재기술	D145	한국나노마이스터고등학교	C316	나노코어	C716	SK하이닉스	D400
스마트에스오씨솔루션	C119	호리바 에스텍 코리아	C423	테크위드유	D001	우일플루온	C224	모벤시스	C563	비전플러스	D147	렛유인메듀	C320	에스디옵텍스	C718		
뉴로클	C120	디피아이엔	C425	바움	D001	토요탄소코리아	C226	링크제니시스	C564	라오닉스	D148						
크레스트	C121	아이엠티	C427	지엘에스	D001	에이엠테크	C228	진성나노텍	C568	LX세미콘	D201						
테스트웍스	C122	플래티지	C429	수퍼게이트	D001	가나	C229	코어플로우코리아	C569	원익아이피에스	D209						
마이다스시스템	C125	코리아스펙트럴프로덕츠	C431	한중시스템IC협력연구원	D001	에스제이티	C231	프라스토솔루션	C570	피엑스케이	D212						
가온칩스	C127	일렉코리아	C433	한국산업기술기획연구원	D001	에이치케이테크	C232	파에조테크놀로지	C571	신성이엔지	D219						
						한국시뮬레이션기술	C233	디씨티	C572	케이씨텍	D222						
						CHIPMETRICS Korea	C234	파스텍	C573	캠라서치	D229						

5. SEDEX Program

10월 25일(수)

시간	프로그램	주최	장소
09:00-18:00	제6회 반도체 산학연 교류 워크숍	한국반도체연구조합	327호
10:00-17:00	첨단 전자실장 기술 및 시장 세미나	한국실장산업협회	308호
10:00-16:00	2023 반도체 환경안전 정책 세미나	한국반도체산업협회	301호
14:00-17:00	반도체시장 전망 세미나	한국반도체산업협회	307호

10월 26일(목)

시간	프로그램	주최	장소
10:00-17:00	제6회 반도체 산학연 교류 워크숍	한국반도체연구조합	307호 317호
10:00-16:50	첨단 전자실장 기술 및 시장 세미나	한국실장산업협회	308호
10:00-12:00	네덜란드 기술세미나	네덜란드 대사관	301호
13:00-14:00	제18회 반도체장학증서 수여식	한국반도체산업협회	300호
14:00-15:20	SEDEX 2023 Keynote	한국반도체산업협회	401호

10월 27일(금)

시간	프로그램	주최	장소
14:00-17:00	첨단산업 인재양성 부트캠프 사업 수혜학생 기업설명회	한국산업기술진흥원	308호

6. SEDEX Event

온/오프라인 이벤트 개최

유튜브 구독 이벤트

SEDEX 유튜브 채널 구독하고 선물받자!

SEDEX 유튜브 구독 이벤트

이벤트 기간 : 2023년 10월 13일(금) ~ 27일 (금), 15일간
당첨자 발표 : 2023년 11월 중 / 유튜브 게재



SEDEX Semiconductor Exhibition ▼

25회를 맞이한 SEDEX가
6명에게 준비한 특별 이벤트



6명



이벤트 참여방법



SEDEX 유튜브 채널
구독, 좋아요



이벤트 영상에
좋아요 & SEDEX 응원 댓글



간단한 설문조사
참여하면 끝!

카드뒤집기 이벤트

SEDEX 2023에 방문해주신 참관객분들을 위한 행운 가득한 이벤트

두근두근, 카드 뒤집기 이벤트

2023 S E D E X

이벤트 기간 : 2023년 10월 25일(수) ~ 27일 (금), 3일간
장소 : 전시장 내 이벤트존



27명

맥세이프 무선충전기



30명

FRESH 바디케어 제품



30명

치킨 쿠폰

카드 뒤집기에 참여하고
선물 받아 가세요~



180명

커피 쿠폰



1,200명

SEDEX 에코백

전시장 내 이벤트존으로
이셔서서 모아주세요!

* 참관객 출입증 QR을 소지하신 분만 참여가 가능하며, 중복 참여는 불가능합니다.
* 5만원 초과와 상품에 대한 제세공과금 22%는 본인 부담입니다.

온/오프라인 뉴스, 전문지, 경제지, 블로그 등 230여회 노출

新메모리·팹리스까지...K반도체 게임체인저 다 모였다

2023 반도체대전 오늘 개막

삼성·SK 등 국내의 기업 총출동
320개 회사서 830개 부스 개설
생생형 AI 주제 기조연설 준비
시스템반도체 등 신제품 소개

반도체 설계부터 전(전) 공정 생산, 패키징에 이르기까지 우리나라 반도체 생태계를 구성하는 기업들이 한자리에 모인다. 25일 개막을 앞둔 국내 최대 규모 반도체 전시회인 '반도체대전(SEDEX 2023)'이 그 무대다. 시장분석기관마다 차이는 있지만 오는 2030년 반도체 시장은 서버·스마트폰·PC·산업용·전장 등을 포함해 1조달러(약 1340조 원) 규모로 커질 것으로 예측되고 있으며 이런 전시회에서는 각 분야별 국내 기업들의 기술 수준과 시장 전망 등을 점검할 기회가 될 것으로 보인다.

한국반도체산업협회는 오는 25일부터 27일까지 서울 코엑스 전시장에서 반도체 대전을 개최한다고 24일 밝혔다. 올해 행사 총 320개 기업이 830개 부스를 운영해 사상 최대 규모로 개최된다.

○삼성·SK, 핵심기술과는 전시회에서 국내 반도체와 양대산맥 격인 삼성

반도체대전 SEDEX 2023 개요

- SEDEX 2023 October 25-27, 2023 COEX
- 반도체 산업의 교육 워크숍
- 최신 전자공학 기술·시장 세미나
- 2023 반도체 환경관련 정책 세미나
- 반도체 시장 전망 세미나
- 네덜란드 기술 세미나
- 제18회 반도체장학증서 수여식
- 최신산업 인태양성 부트캠프 시업 수혜학생 기조연설

반도체대전 SEDEX 2023 기조연설

AI 시대 인간을 이롭게 하는 반도체

박승민
삼성전자 시스템·프로그래밍 부장

생생형 AI 시대에 필요한 반도체와 AI 슈퍼컴퓨팅의 미래

김정호
KAIST 교수

첫 QPT 시대와 인공지능 반도체

박성민
라벨리온 대표

자료: 한국반도체산업협회

전자와 SK하이닉스는 최첨단 반도체를 소개한다. 삼성전자는 자체 메모리 반도체도 물론인 컴퓨팅시스템(CX L), 최첨단 파운드리·패키징 공정, 올해 예상치 못한 글로벌 수요를 앞둔 예치소 2400 킬로미터 AI 반도체에 걸맞은 다양한 제품을 부스에서 공개할 예정이다.

SK하이닉스는 올해 두꺼웠던 반도체인 고대역폭메모리(HBM)의 최신 제품 HBM3E를 소개한다. 메모리 안에 서도 연산을 할 수 있는 프로세서인 메모리(PIM) 기반 AI 가속기 카드 'AM X'를 비롯해 서버용 DDR5 DRAM, 일렉트로닉 솔리드스테이트 드라이브(SSD) 저

장 장치 등을 전시한다. 삼성전자는 SK하이닉스와 에도 시스템 반도체 설계, 국내외 소부장 업체까지 각 분야 최고의 글로벌 기업들이 기술을 뽐 내는 장소에 됐다. 세계 최대 반도체 전시회이자 미국 캘리포니아, 한국 대표 반도체 장비 기업인 한미반도체를 포함해 파세케이, 엑시온, 주상전자·이머 등 이 참가하고 소재 기업 동진세미, 에프에스, 미코와 KSM 등이 전시 공간을 꾸민다.

○AI 반도체 어디까지 왔나=반도체 산업업회는 올해 전시회 슬로건을 'AI와 반도체 혁신, 미래를 연결하는 힘'으로

정하고 관련 분야에 대해 심층적으로 접근할 수 있는 무대를 마련했다. 25일에는 삼성전에서 시스템 반도체 설계계를 총괄하는 박승민 부장이 'AI 시대, 인간을 이롭게 하는 반도체'를 주제로 무대에 오른다. 평소 그가 강조해 왔던 '시스템·LSI 유마노이드' 비전과 AI 시대에 필요한 고성능 반도체에 대해

강연할 것으로 보인다. AI 반도체 학회로 유명한 김경호 한 과학기술원(KAIST) 교수는 '생생형 AI 시대에 필요한 AI 반도체와 AI 슈퍼컴퓨팅의 미래'를, 전도유관한 AI 반도체 팹 라리로 잘 알려진 라벨리온의 박성민 대

표는 '첫 QPT 시대와 인공지능 반도체'라는 주제로 기조연설을 할 예정이다.

국내 팹리스 기업의 AI 반도체 개발 동향을 한 눈에 파악할 수 있는 약 100부스 규모의 '시스템반도체 존'도 마련됐다. 국내 최대 팹리스기업인 LX세미콘이 팹리스와 슈퍼컴퓨팅은 신성장동력(NP U) 기반으로 AI 반도체 제품을 공개한다. AI 분야 최강의 영상 솔루션을 제공한 반도체 설계자사인 IP 전문기업인 집스엔 미디어, 고화질 NPU와 자체 고성능 메모리반도체를 IP를 개발하는 오메가테크놀로지도 참가한다. 산업통상자원부에서 추진하는 글로벌시스템스기업으로 선정된 스카이온시스, 에이디테크놀로지, 사파이어반도체, 솔리드퓨 등도 관심을 맞을 준비를 끝냈다.

반도체산업협회는 전시장에서 반도체 기술·시장 트렌드를 분석하는 자리도 마련했다. 전시장에서는 국내 유명 팹리스와 학계가 참여하는 반도체시장전망 세미나, 대한전기공업회의 반도체 산업 교류 워크숍이 개최된다. 김경호 한국반도체산업협회 부회장은 "올해 전시회에서는 자체 팹리스기업인 물론 우리 반도체 회사들의 노력을 면밀히 살펴볼 수 있는 것"이라고 말했다. **김명희 기자**

반도체 화두 AI...삼성·SK, 차세대 HBM 격돌

〈고려경제포럼〉

SEDEX 2023

HBM3E 내세워 주도권 노려
고체 테스트 후 이른바 내년 양산
IP 기업도 AI 시장 공략 가속
소부장 공작기술 혁신 성과 소개



삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 HBM3E 고대역폭메모리

삼성전자의 SK하이닉스의 차세대 고대역폭메모리(HBM) 관련 소부장 사업에 대해, 양사 모두 5나노 HBM이라 불리는 'HBM3E' 제품을 국내 최대반도체 전시회에서 동시에 공개했다. 인공지능(AI)가 급부상하면서 수요가 증가하는 HBM 시장에서 두 기업이 경쟁하는 것으로 보인다. AI가 반도체 생태계 주역으로 자리매김하면서 업계 경쟁도 심화되고 있다.

○HBM3E 대전 '삼성전자 VS SK하이닉스' 삼성전자의 SK하이닉스는 서울 코엑스에서 개막한 전시회인 '반도체대전(SEDEX 2023)'에서 HBM3E를 전면에 내세웠다. HBM3E는 AI 산업에 연결, 대용량 데이터를 신속하게 처리할 수 있는 차세대 메모리다. 엔비디아를 필두로 AMD와 인텔 등 AI 반도체 제조사 HBM3E 탑재 제품을 준비 중이다. 삼성전자는 이날 최고경영자(CEO)인 이재우가 HBM3E를 소개했다. 삼성전자가 국내 HBM3E 제품을 공개한 건 처음이다. 현재 주로 고객사에 샘플을 제공하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이

닉스는 역시 엔비디아에서 신성장 동력을 받고 있는 HBM3E를 선보였다. 양사가 모두 반도체 3세대인 HBM3E를 앞세워 AI 시장에서 주도권을 잡겠다는 포부로 풀려나고 있다. HBM3E는 고객사 테스트를 통과한 뒤 이르면 내년 상반기 본격 양산에 돌입할 전망이다. SK하이닉스는 현재 HBM3 시장에서 경쟁 우위를 견고히 하고 삼성전자의 맹추격을 시장을 뺏아내는 것이 당면 과제다.

○HBM3E 대전 '삼성전자 VS SK하이닉스' 삼성전자의 SK하이닉스는 서울 코엑스에서 개막한 전시회인 '반도체대전(SEDEX 2023)'에서 HBM3E를 전면에 내세웠다. HBM3E는 AI 산업에 연결, 대용량 데이터를 신속하게 처리할 수 있는 차세대 메모리다. 엔비디아를 필두로 AMD와 인텔 등 AI 반도체 제조사 HBM3E 탑재 제품을 준비 중이다. 삼성전자는 이날 최고경영자(CEO)인 이재우가 HBM3E를 소개했다. 삼성전자가 국내 HBM3E 제품을 공개한 건 처음이다. 현재 주로 고객사에 샘플을 제공하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이

닉스는 역시 엔비디아에서 신성장 동력을 받고 있는 HBM3E를 선보였다. 양사가 모두 반도체 3세대인 HBM3E를 앞세워 AI 시장에서 주도권을 잡겠다는 포부로 풀려나고 있다. HBM3E는 고객사 테스트를 통과한 뒤 이르면 내년 상반기 본격 양산에 돌입할 전망이다. SK하이닉스는 현재 HBM3 시장에서 경쟁 우위를 견고히 하고 삼성전자의 맹추격을 시장을 뺏아내는 것이 당면 과제다.

영상을 인코딩 및 디코딩하는 비디오 코덱에 특화된 회사다. 집스엔 미디어는 비디오 코덱이 탑재된 텔레비전의 차량용 인포테인먼트 전용 시스템이다. CMNP는 차량용 영상용 고화질 영상으로 입소문만 나도는 기술인 슈퍼레졸루션(SR), 영상 내 노이즈를 제거하는 노이즈 리덕션(NR) 등 AI 기능을 하드웨어에서 실행할 수 있는 프로세서 IP다. 집스엔 미디어 관계자는 "자율주행과 같이 항구적으로 영상 처리에 대한 수요가 증가하면 비디오 코덱 IP가 더욱 주목받을 것"이라고 밝혔다.

○HBM3E 대전 '삼성전자 VS SK하이닉스' 삼성전자의 SK하이닉스는 서울 코엑스에서 개막한 전시회인 '반도체대전(SEDEX 2023)'에서 HBM3E를 전면에 내세웠다. HBM3E는 AI 산업에 연결, 대용량 데이터를 신속하게 처리할 수 있는 차세대 메모리다. 엔비디아를 필두로 AMD와 인텔 등 AI 반도체 제조사 HBM3E 탑재 제품을 준비 중이다. 삼성전자는 이날 최고경영자(CEO)인 이재우가 HBM3E를 소개했다. 삼성전자가 국내 HBM3E 제품을 공개한 건 처음이다. 현재 주로 고객사에 샘플을 제공하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이

닉스는 역시 엔비디아에서 신성장 동력을 받고 있는 HBM3E를 선보였다. 양사가 모두 반도체 3세대인 HBM3E를 앞세워 AI 시장에서 주도권을 잡겠다는 포부로 풀려나고 있다. HBM3E는 고객사 테스트를 통과한 뒤 이르면 내년 상반기 본격 양산에 돌입할 전망이다. SK하이닉스는 현재 HBM3 시장에서 경쟁 우위를 견고히 하고 삼성전자의 맹추격을 시장을 뺏아내는 것이 당면 과제다.



LSI세미콘 부스에서 고객에게 인터페이스 이미지 데이터 솔루션 등 기술을 보고 있다.

박지호 기자 jhnews@etnews.com

이 필수'라면서 '스마트폰이나 차량에 사용되는 MIP 규격이나, 서버 등에 활용될 수 있는 PCIe 규격 등 다양한 차이의 반도체 IP가 활용될 수 있을 것'이라고 전했다.

국내 최대 팹리스인 LX세미콘은 반도체 관련에서 신성장 동력을 소개했다. 기존 LSI(시스템·LSI)에 추가해 AI에 주목했다. LX세미콘은 최근 전력 관리반도체(PMC), 전력 반도체, LDC 등 다양한 카테고리의 인터페이스 IP 포트폴리오를 소개했다. 시스템온칩(SOC) 모듈 내에 적용한 데이터가 빠르게 오갈 수 있도록 하는 반도체 기술을 주력으로 하는 업체다. 삼성전자의 파운드리 IP 협력사가기도 하다. 최근 코엑스에 상공했다. 팹리스반도체 관계자는 "인제자사(IP)인 CMNP를 선보였다.

은으로 파워와인(EUV) 감광(포토 레지스트 PR) 기술 성과를 공개했다. 동진세미콘은 2021년말 EUV PR 개발을 완료하고, 자체 개발한 반도체에 적용을 성공했다고 성과에 대해 밝혔다. 최근 반도체 대안에서 EUV PR 관련 기술 개발은 공개하지 않았다. 올해 본격적인 제품 양산이 시작되면서 대외 성과를 알린 것으로 보인다.

○HBM3E 대전 '삼성전자 VS SK하이닉스' 삼성전자의 SK하이닉스는 서울 코엑스에서 개막한 전시회인 '반도체대전(SEDEX 2023)'에서 HBM3E를 전면에 내세웠다. HBM3E는 AI 산업에 연결, 대용량 데이터를 신속하게 처리할 수 있는 차세대 메모리다. 엔비디아를 필두로 AMD와 인텔 등 AI 반도체 제조사 HBM3E 탑재 제품을 준비 중이다. 삼성전자는 이날 최고경영자(CEO)인 이재우가 HBM3E를 소개했다. 삼성전자가 국내 HBM3E 제품을 공개한 건 처음이다. 현재 주로 고객사에 샘플을 제공하고 있는 것으로 알려졌다. SK하이

[출처] SEDEX 2023 반도체대전 방문 후기 대체는 역시 AI 전기차 한국에서 가장 큰 반도체 전시회 중 하나! 작성자 징징이

[출처] LX세미콘의 비메모리 반도체와 전력 반도체 일상 속 발견!! SeDEX 2023에서 놀란 관람객 반응!!(feat. B2B) (tistory.com)

[출처] SEDEX 2023 반도체대전 후기(feat. KES 2023 한국전자전) | 작성자 songmallang

여러 가지 프로그램들이 있는데
사전등록 당시에도 이미 마감된 프로그램이 많아서
사실 방문을 해도 거의 관람밖에 못할 거 같아요!

그리고 찾아간 삼성 부스
사실 반도체 TCON DDR 이야기해도
실물 보기 전까지는 상상하기 어려운데
실물도 볼 수 있고
기술적으로 어떤 장점을 가지는지 알 수 있어서 유익했어요

AI시대,
인간을 이롭게 하는 반도체
AI 반도체의 국내 기술력을 한 눈에 파악할 수 있는 기회
SEDEX 2023 추천합니다

8. SEDEX 2024 준비

개최 개요

- 명 칭 : 제26회 반도체대전 (SEDEX 2024)
- 기 간 : 2024년 10월 23일(수) ~ 25일(금), 3일간
- 장 소 : 서울 삼성동 COEX Hall C & D1
- 주 최 : 산업통상자원부
- 주 관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합
- 참가사 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비·부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체관련 기업 250개사 700부스

참가 신청



- 1차 : ~2023.12.29(금) ☞ 참가비 15% 할인
- 2차 : ~2024.04.30(화) ☞ 참가비 10% 할인
- 3차 : ~2024.06.28(금) ☞ 참가비 5% 할인

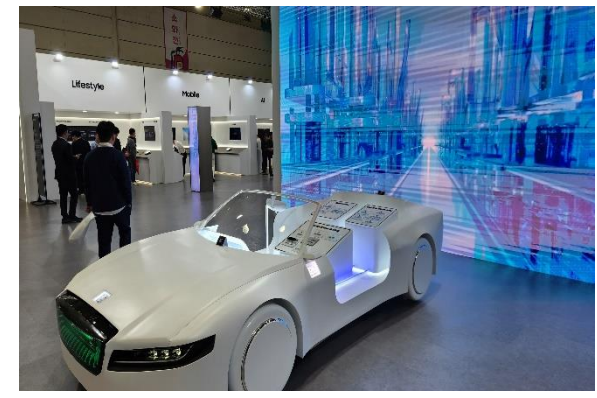
* 3년(2022~2024년) 연속 참가기업 추가할인 5%

* 부스 소진 시 조기 마감)

반도체산업의 기술혁신을 위한 새로운 2024년 시작

- ✓ 산학연 프로그램 활성화 : 기관, 단체, 지자체, 대학 참여 확대
- ✓ 참가기업의 홍보 및 마케팅 프로모션 지원
- ✓ 반도체산업 체험 프로그램 확대
- ✓ 비즈니스상담회 및 실질적인 B2B 교류 강화

9. SEDEX Proto Gallery



감사합니다